

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Версия	Данные OMNIMATE – штекер USB, Штекеры USB, 480 Мбит/с, Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 180°, ≥ 10000, Шаг в мм (P): 0.65 mm, Количество полюсов: 5, LCP, черный, Таре
Заказ №	2762070000
Тип	USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
GTIN (EAN)	4064675035299
Кол.	2 000 Шт.
Упаковка	Таре

Дата создания 5 июня 2024 г. 0:32:45 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2,9 мм	Глубина (дюймов)	0,114 inch
Высота	10,51 мм	Высота (в дюймах)	0,414 inch
Ширина	7,99 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Масса нетто	0,299 g		

Упаковка

Упаковка	Tape	Длина VPE	462 мм
VPE с	450 мм	Высота VPE	166 мм

Системные характеристики

LED	Нет	Вид защиты	IP20
Вид соединения	Гнездо	Длина штифта для припайки (l)	0 мм
Допуск на расположение выводов под пайку	± 0,1 мм	Категория эксплуатационных характеристик	480 Мбит/с
Количество полюсов	5	Материал экрана	Нержавеющая сталь
Монтаж на печатной плате	Соединение под пайку для поверхностного монтажа	Поверхность экрана	никелированный
Размеры выводов под пайку	восьмиугольный	Серия изделия	Данные OMNIMATE – штекер USB
Скорость передачи	480 Мбит/с	Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную
Угол вывода	180°	Усилие вставки на полюс, макс.	35 N
Усилие вытягивания на полюс, мин.	10 N	Циклы коммутации	≥ 10000
Шаг в дюймах (P)	0,026 "	Шаг в мм (P)	0,65 мм
Экранирование	Да		

Электрические свойства

Номинальное напряжение	48 V	Номинальный ток	1 A
Объемное сопротивление	<25 mΩ	Прочность изоляции	≥ 100 MΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	100 V AC		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Прочность изоляции	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал контактов	Сплав медный	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Структура слоев штепсельного контакта	≤ 1 μ" Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-30 °C	Рабочая температура, макс.	80 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[Änderung der Verpackung – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK](#)[Change of packaging – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

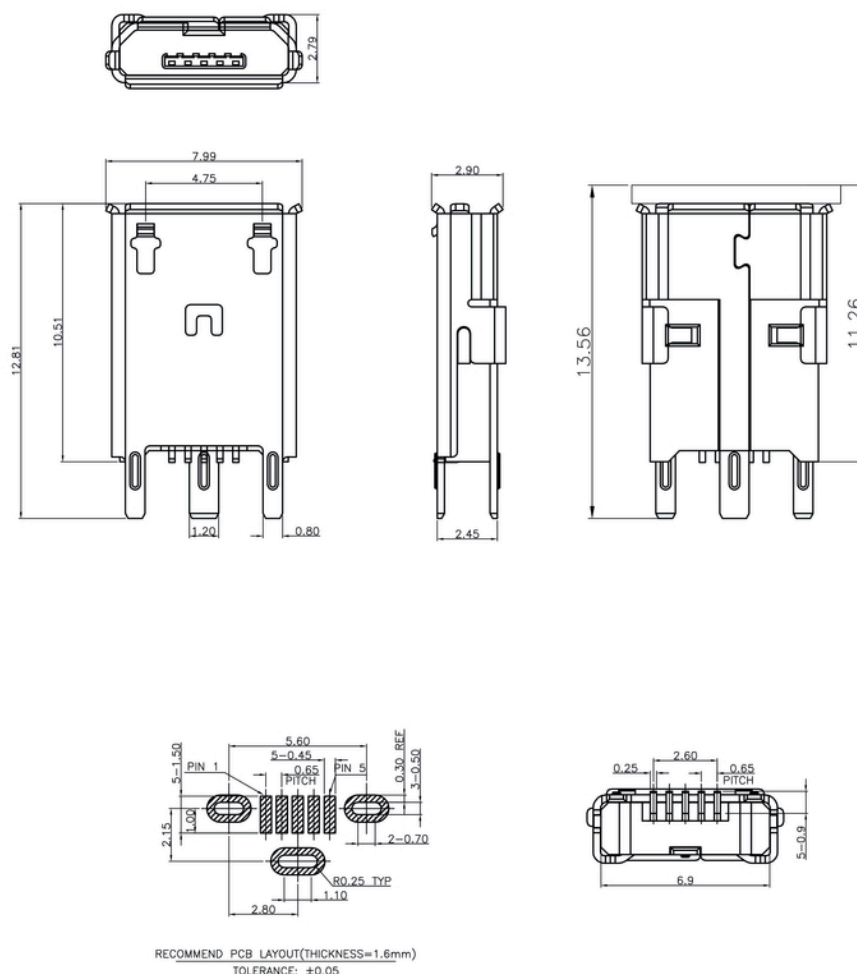


USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.